

A Promising Journey to Silicon Success

ASICLAND

Investor Relations 2026



DISCLAIMER

- 본 자료는 주식회사에이직랜드(이하 “회사”)의 사업 및 재무현황에 대한 이해를 돕기 위하여 기관투자자를 대상으로 작성된 자료입니다.
- 본 자료의 무단 반출, 복사 또는 제3자에 대한 재배포는 금지되며, 본 자료의 열람은 이에 대한 동의로 간주됩니다.
- 본 자료에 포함된 재무정보 및 사업 계획 등은 현재 시점을 기준으로 작성된 것으로, 향후 시장환경 및 경영전략의 변화 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 특히, 본 자료에 포함된 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등의 표현은 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있으며, 이는 다양한 변수 및 불확실성에 의해 실제 결과와 중요한 차이가 발생할 수 있습니다.
- 회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성 및 완전성을 보장하지 않으며, 본 자료의 이용과 관련하여 발생하는 어떠한 손실에 대해서도 법적 책임을 부담하지 않습니다.
- 본 자료는 주식의 매입 또는 매도 등 투자 권유를 목적으로 작성된 것이 아니며, 투자에 관한 모든 의사결정은 투자자 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
- 투자 판단은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 자료를 기준으로 하시기 바랍니다.
- 본 자료는 회사의 사전 승인 없이 내용 변경 또는 무단 배포가 금지됩니다.

Company Overview

01

- 01 _ 회사 개요
- 02 _ 성장 히스토리
- 03 _ 글로벌 파트너스
- 04 _ 사업 범위 – Turnkey Service
- 05 _ 주요 고객사
- 06 _ 2024 ~ 2026년 주요 성과

[VISION]

끊임없는 혁신과 글로벌 네트워크로 세계를 선도하는 시스템 반도체

VALUE-UP PARTNER

에이직랜드는 에이직을 사랑하는 사람들이 함께 모여
최고의 기술과 신뢰를 바탕으로 모든 이해관계자와 소통하며
동반 성장하는 행복한 기업을 꿈꿉니다.



글로벌 ASIC 디자인 솔루션 대표기업 ASICLAND

일반 현황

“글로벌 No.1 디자인 솔루션 기업으로”

이종민 대표이사

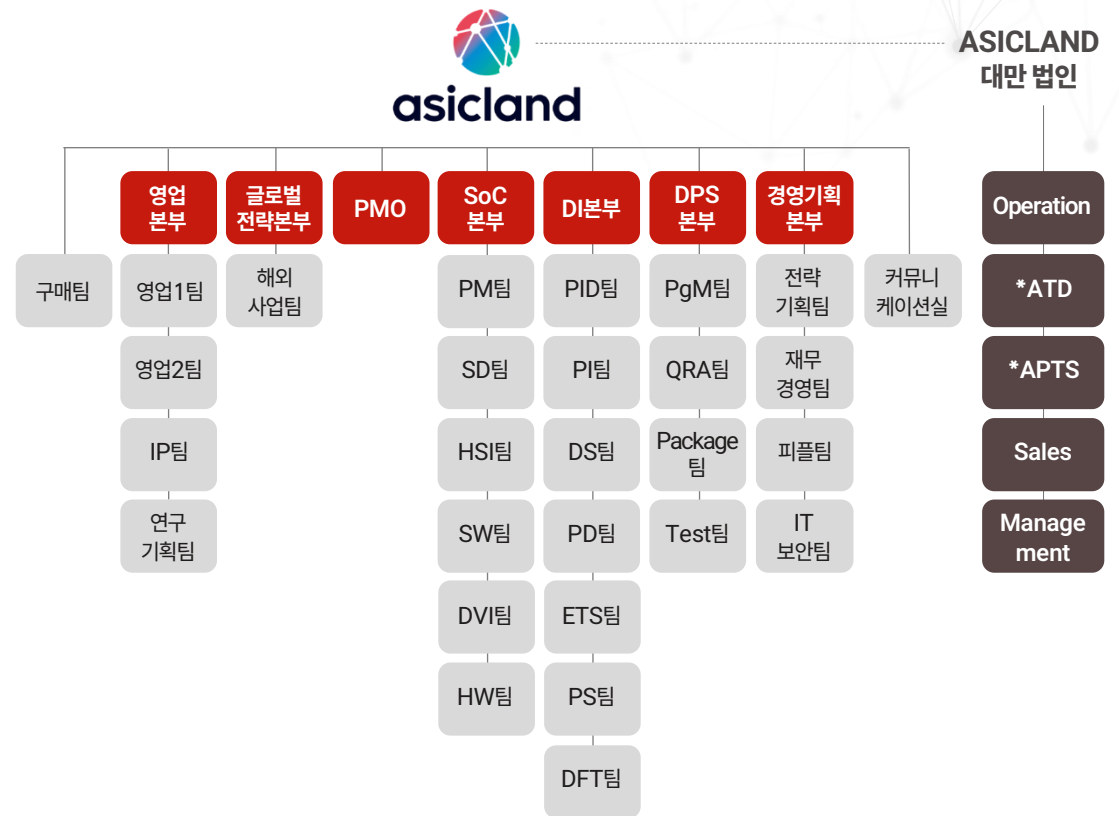
- 2003 SK하이닉스 반도체 연구원
- 2005 (주) 버추얼다임 책임연구원 : SoC개발팀
- 2009 (주) 휴먼칩스 수석연구원 : ASIC개발팀
- 2012 (주) 다윈텍 수석연구원 : ASIC개발팀
- 2016 (주) 에이직랜드 대표이사



회사명	(주)에이직랜드
대표이사	이종민
설립일	2016년 4월 5일
자본금	54.62억 원
임직원수	260명
주요산업	주문형 반도체 디자인 서비스, 시스템 온 칩 제품 개발
주소	경기도 수원시 영통구 대학4로 25 에이직랜드빌딩
홈페이지	www.asicland.com

자료 : 당사 내부자료 (2026년 03월 말 기준)

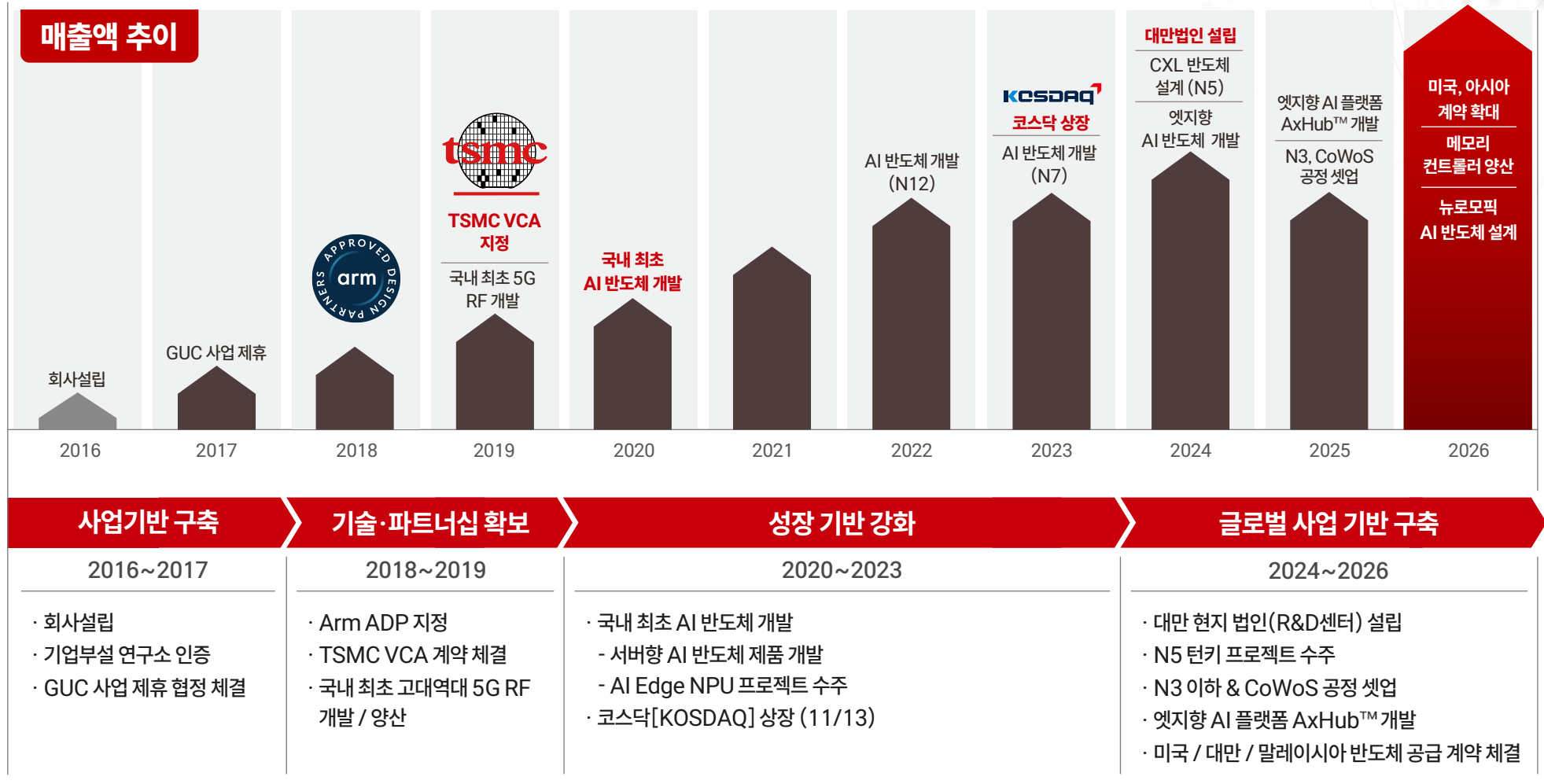
회사 조직도



*ATD : Advanced Technology Development Division

*APTS : Advanced Packaging Technology Simulation Division

글로벌 No.1 파트너십 기반으로 대표적인 ASIC 디자인 솔루션 기업으로 성장



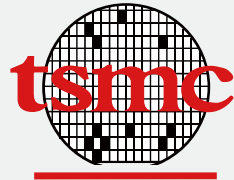
자료 : 전자공시 시스템 감사보고서, 당사 내부자료

국내 유일 TSMC VCA & Arm의 ATD 글로벌 No.1 파트너들과 함께 동반 성장

Global No.1 Foundry's - 'TSMC' Korea's only TSMC VCA Partner

글로벌 파운드리 No.1 TSMC의
생태계 핵심인 VCA로서 디자인솔루션 내 독보적 위치

TSMC의 VCA로서 높은 공정 이해도 기반
Spec-In부터 턴키 솔루션 제공



*VCA (Value Chain Alliance)

ATD & ADP of Arm, the world's largest IP company

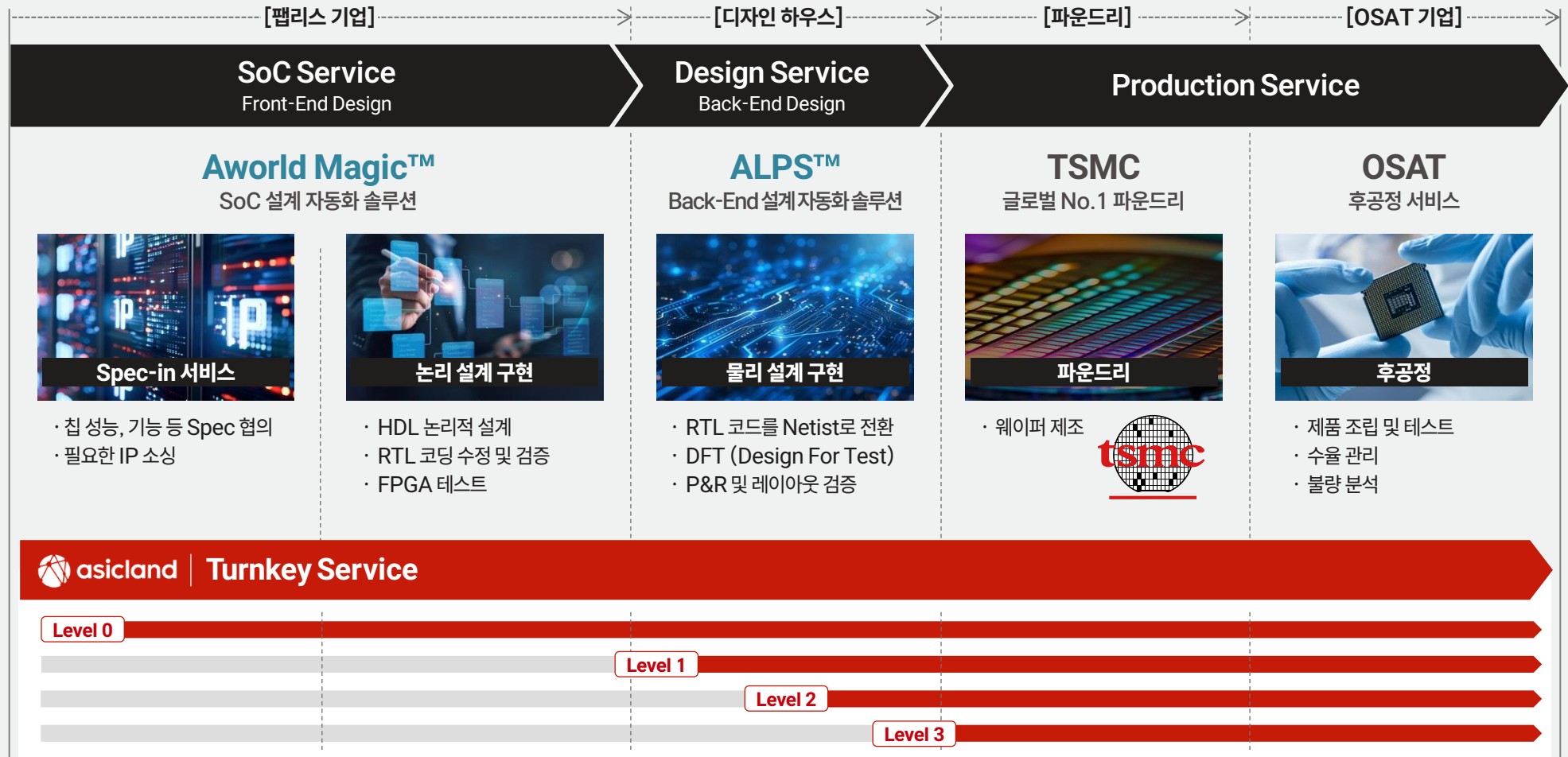
글로벌 최대 IP 기업 Arm의 지정 공식 파트너로서
글로벌 메이저 파트너들과 동반 성장

'Arm Total Design' 프로그램 파트너로 선정



*ATD (Arm Total Design Partner) | *ADP (Arm Approved Design Partner)

통상적인 디자인 하우스와 차별화된 턴키 서비스(설계~공급) 제공



AI · Memory 등 4차 산업 주요 고객에게 최적의 디자인 솔루션 제공

대기업과 중소기업, 스타트업 등 70여개의 다양한 고객사 확보 / 양산 가능성이 높은 애플리케이션 분야 집중



DISPLAY

- T-Con (Timing Controller) 제품화 설계 및 생산 지원
- 스마트글라스 컨트롤러



AI

- 국내 최초 AI 반도체 개발
- 온디바이스 AI 반도체 신규 개발
- HPC(고성능 컴퓨팅) CPU 개발
- 미국 뉴로모픽 AI 칩 개발 계약



MEMORY

- 칩렛 기반 CXL 컨트롤러 개발
- 차세대 eSSD 컨트롤러 개발
- eMMC 컨트롤러 개발 및 양산



IoT & 5G

- 국내 최초 고대역대 5G RF칩 양산
- 미국 기업 RF칩 신규 개발



AUTOMOTIVE

- 차량용 고속 인터페이스 칩
- 자율주행 SoC 칩 개발



글로벌 사업 확장 기반 구축 글로벌·국내 신규 프로젝트 수주 확대

차세대 프로젝트 수행 · 대만 법인 설립 · 글로벌 계약 체결

Global

● [에이직랜드 대만 법인과 N3 이하 선단 공정 및 CoWoS 패키지 Setup] →



06.21.
미국 'PHYTunes'
RF칩 신규 계약



08.20.
대만 법인 설립
(R&D센터)



11.06.
대만 '이지스테크놀로지'
글로벌 AI 서버 칩
공동 개발 협력



06.11.
미국 종합반도체(IDM)
기업 차량용 반도체
설계 공급 계약



12.08.
글로벌고객사,
Programmable SoC
양산 계약



02.23.
미국 뉴로모픽 AI
'Brainchip'
개발 계약 체결



03.12.
말레이시아 기업
신규 프로젝트 계약

2024

2025

2026

Local



05.13.
엣지향 AI 반도체
신규 계약 체결



07.31.
'파두'
eSSD 컨트롤러
개발 계약 체결



11.04.
'SK하이닉스'
N5 CXL 컨트롤러
개발 계약 체결



04.29.
'수퍼게이트'
AI VPU
개발 계약 체결



08.12.
'프라임마스'
칩렛 SoC
개발 계약



10.23.
피지컬 AI 플랫폼
'AxHub™' 공개



01.08.
스토리지 컨트롤러
양산 계약



01.12.
'프라임마스'
CXL 컨트롤러
개발 확대

Performance & Growth Strategy

02

- 01 _ Investment Highlights
- 02 _ Market Trend : AI·메모리·ASIC 수요의 구조적 동반 성장
- 03 _ AI·Memory 핵심 수혜자, ASICLAND
- 04 _ 차세대 선단 설계·패키징 기술 역량 확보
- 05 _ 글로벌 비즈니스 가속화



메모리 시장 성장의 핵심 수혜자 고성장 메모리 중심 프로젝트·양산 확대, 가파른 매출 성장 구간 진입

메모리 산업과 함께 성장하는 에이직랜드

- AI 인프라 투자 확대 → 메모리 시장 성장 가속 → 컨트롤러 수요 증가
- 고성장 메모리 분야 글로벌 핵심 고객사 확보
 - [Y사] N3~N6, 차세대 메모리 컨트롤러 개발 협력
 - [CC사] 고성능 eSSD 컨트롤러 개발 및 양산



개발에서 양산으로, 매출 체질 개선

- 개발 완료 프로젝트의 순차적 양산 진입
- 양산 매출 비중 확대에 따른 수익 개선 본격화
- 특히, AI·메모리 분야 집중을 통한 양산 확대 & 수익성 개선



차세대 선단 설계·패키징 기술 역량 확보

- 대만 R&D센터를 기반으로 N3이하 선단공정, CoWoS 역량 장착
- TSMC의 압도적 수율과 안정적 공정 기반 자동화 플랫폼 구축
 - [AxHub™] 엠티향 AI 반도체 시간·비용 60% 이상 단축
 - [고성능 SoC 플랫폼] 서버향 AI·HPC 시장 대응력 확대
 - TSMC 2.5D(CoWoS) 패키징 기반 Chiplet 기술력 확보



글로벌 비즈니스 가속화

- 해외 진출 1년 만에 분기 매출 106억 달성 ('26년 1분기)
- 시장 기회를 활용하여 북미 시장 진출 ('28년 미국 법인 설립 예정)
 - N3~N28 공정에서 시장 진입 기회 확인
 - 유망 중소·스타트업 밀착 협력으로 고객과 동반 성장
 - 대만 법인을 통한 선단공정·첨단 패키징 고객 대응 강화



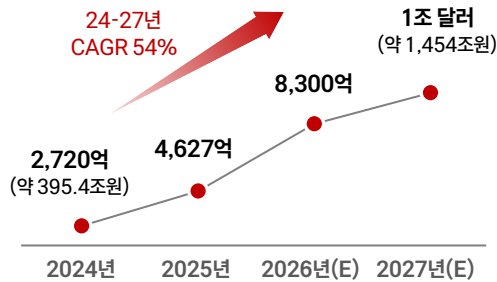
Global Key Trend

AI 인프라 투자 확대가 이끄는 컨트롤러 ASIC 수요

글로벌 AI 인프라 투자 확대

AI 인프라 투자는 일시적 현상이 아니라
고성장 사이클(Cycle) 진입 과정

빅테크·하이퍼스케일러 Capex 추이 (단위: 달러)



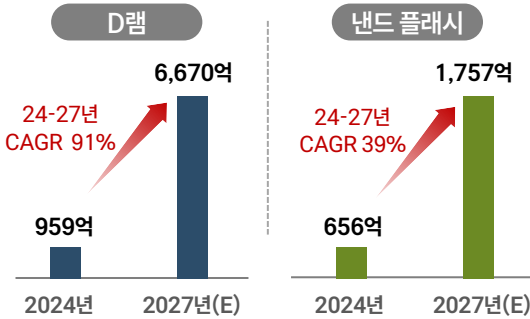
Key Points

- ✓ AI 시장 선점을 위한 인프라 투자 확대 (자체 ASIC, 데이터센터, 네트워크 등)
- ✓ 반도체 산업 구조적 성장 견인

메모리 수요 증가

메모리 시장 성장 가속

메모리 시장 전망 (단위: 달러)



AI 데이터 센터가 촉발하는 수요 증가 요인

- ✓ AI 모델 고도화로 데이터 생성·처리량 폭증
- ✓ 대용량 데이터를 빠르게 처리할 수 있는 고성능 메모리 필요

메모리 컨트롤러 수요 동반 성장

메모리의 두뇌 역할인
컨트롤러 수요 구조적 동반 성장

메모리·컨트롤러 확산 흐름



메모리 컨트롤러의 핵심 역할 및 기능

- ✓ 데이터 입출력 제어 및 성능 최적화
- ✓ 전력 효율 관리 및 시스템 안정성 제공

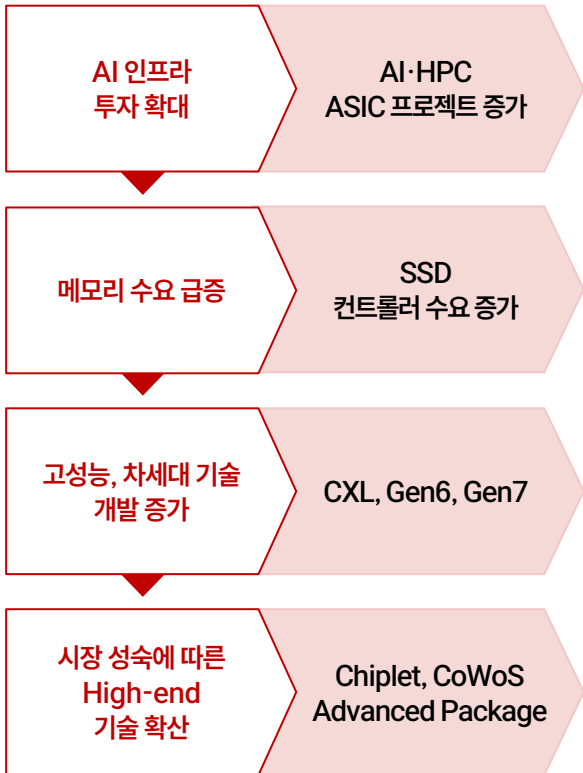
자료 : 트렌드포스, 밴크오브아메리카

메모리 분야 글로벌 Top-tier 고객 확보 + 인정 받은 기술력

Memory 수혜 구조 완성, **ASICLAND 실적 상승 견인**

에이직랜드 메모리 수혜 구조 완성

시장의 변화 ▶ 에이직랜드의 연관성



독보적인 메모리 분야 경쟁력

에이직랜드 핵심 경쟁력

- ✓ 메모리 분야 글로벌 Top-tier 고객사 확보
- ✓ 메모리 ASIC 분야 기술력 & 신뢰성 입증
- ✓ 압도적인 TSMC 선단공정 및 패키지 기술

메모리 분야 고객사별 주요 프로젝트

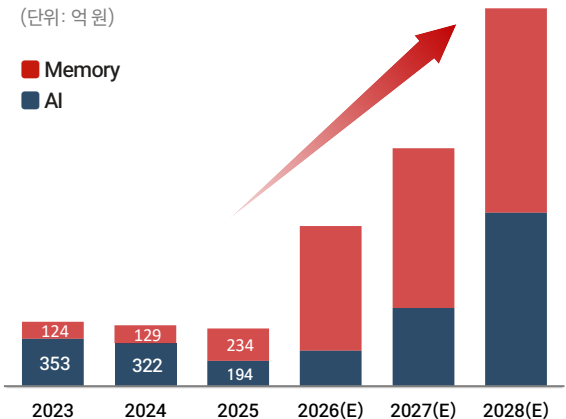
Y사	낸드 플래시 개발 협력
CC사	차세대 eSSD 컨트롤러 개발 후 양산
Q사	CXL 컨트롤러 개발 후 양산
A사	eMMC·UFS 컨트롤러 개발 후 양산

AI·메모리 분야 실적 상향 가속

중장기 성장 Point

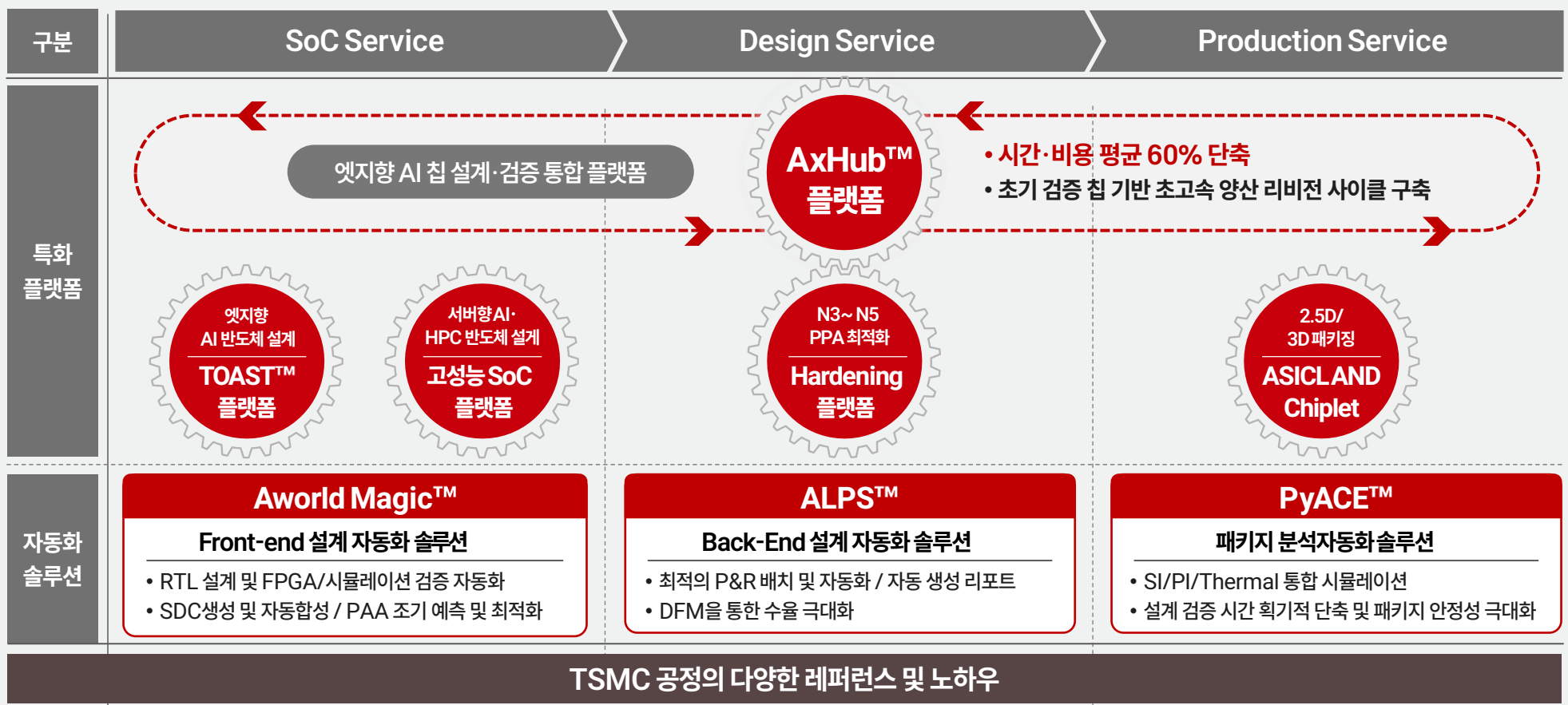
- ✓ 글로벌 메모리 고객사와 장기 파트너십 형성
 - 고객 매출 증가 = 에이직랜드 양산 실적 증가
 - 성공적 레퍼런스 기반 차세대 제품 개발

에이직랜드 AI·Memory 매출 전망



글로벌 시장 대응을 위한 반도체 설계·패키징 분야의 선단 필수 기술 확보

독보적 자동화 플랫폼으로 비용·성능·개발기간 최적화 / 양산 성공 가능성 극대화



글로벌 시장 대응을 위한 반도체 설계·패키징 분야의 선단 필수 기술 확보

엣지향 AI를 시작으로 고성능 HPC·Chiplet 까지 글로벌 시장 필수 설계 역량 완비

	<p>AxHub™ Platform</p>	<p>고성능 SoC Platform</p>	<p>ASICLAND Chiplet</p>
<p>주요 역할</p>	<p>엣지향 AI 반도체 초기 개발 비용·기간 단축</p>	<p>AI 및 HPC 서버 시장 경쟁력 확보</p>	<p>여러 기능의 칩을 하나의 패키지로 통합</p>
<p>핵심 가치</p>	<p>Fast & Stable (신속한 설계·검증)</p>	<p>Powerful & Scalable (압도적 성능)</p>	<p>Flexible & Optimized (설계 유연성)</p>
<p>주요 스펙</p>	<p>Arm Cortex-A76 / Synopsys IP 기반</p>	<p>Arm Neoverse CSS N2 (N5 공정, 64코어)</p>	<p>TSMC CoWoS (2.5D 패키징) 기반</p>
<p>특/장점</p>	<p>시간·비용 평균 60% 단축, 고객 Lock-in 효과</p>	<p>완성형 고성능 SoC 패키지</p>	<p>모듈화로 성능·비용 최적화</p>
<p>주요 응용처</p>	<p>엣지향 AI</p>	<p>고성능 컴퓨팅(HPC), AI 데이터센터</p>	<p>초고성능 AI 가속기 및 서버 시스템</p>
<p>마켓 포지셔닝</p>	<p>초기 도입 시장 (실리콘 검증·양산전환)</p>	<p>대형·성숙 시장 (AI·HPC 중심)</p>	<p>중기 확산 시장 (하이엔드 패키징)</p>

TSMC 기술·생태계 기반의 차세대 글로벌 확장 전략

대만 법인을 통한 선단공정·첨단 패키징 역량 고도화 + 미국 시장 진출을 통한 TSMC 글로벌 파트너로 성장



대만 선단공정과 북미 생태계 기회를 연계한 글로벌 시장 확장 전략



글로벌 최대 시스템 반도체 시장, 북미 시장 기회를 활용한 북미 고객 확보

TSMC 생태계 내 보완적 협력 관계 기반 북미 시장 진입 / 유망 중소·스타트업 밀착 협력으로 고객과 동반 성장

TSMC 매출 중 가장 큰 시장, 북미

'26년 1분기 TSMC 북미 매출 비중



북미 **76%**

북미 매출액
약 **39.6조 원**

'26년 1분기 TSMC 공정별 매출 비중

- N5 이하 매출 비중 : 63%
- N7 이상 매출 비중 : 약 37%

최선단	선단 공정			성숙 공정		
	~N3	~N5	~N7	~N20	~N28	그 외
28%	35%	14%	6%	6%	11%	

에이직랜드 타겟 시장

타 VCA(GUC, Alchip) 집중 영역

노드 | N2 ~N5 (최선단 공정 위주)

타겟 | 대형 고객사 위주 / 하이퍼스케일러, 빅테크 등

특징 | 고객 SoC 설계 / Back-end 이후 서비스에 집중

이슈 | 신규/타 공정 프로젝트 수행 어려움 부족

에이직랜드 기회 영역

노드 | N3 ~N28 (선단, 성숙 공정 위주)

타겟 | 중소·스타트업 고객 / 엣지 AI, IoT, 컨슈머 등

특징 | SoC 설계부터 Turn-key 서비스 제공

기회 | 주력 공정 일치, TSMC 생태계내 보완적 협력 확대

북미 고객 확보 전략



타 VCA와의 차별화된 시장 접근

GUC, Alchip의 리소스 이슈 기회 활용
N3~N28 공정 위주의 프로젝트 진행



유망 스타트업 조기 발굴, 동반 성장

유망 중소·스타트업 조기 발굴을 통한
장기적 고객 관계 구축



고객(스타트업) 니즈 적극 대응

자사 플랫폼 활용한 신속/정확한 Tape-out
시차 없는 실시간 고객 대응 체계 구축



대만 R&D 기반 고객 대응 강화

대만법인 선단공정, 첨단 패키징 활용한
점진적 고객 확대

Appendix

03

01_TSMC OIP 생태계 : VCA 역할



“TSMC VCA” 로서 TSMC의 OIP 생태계 내에서 팹리스 고객의 최일선 영업 담당 및 핵심 역할 수행

TSMC의 OIP 생태계 (Open Innovation Platform)

TSMC의 비즈니스 모델



TSMC의 OIP 생태계 (Open Innovation Platform)

VCA*

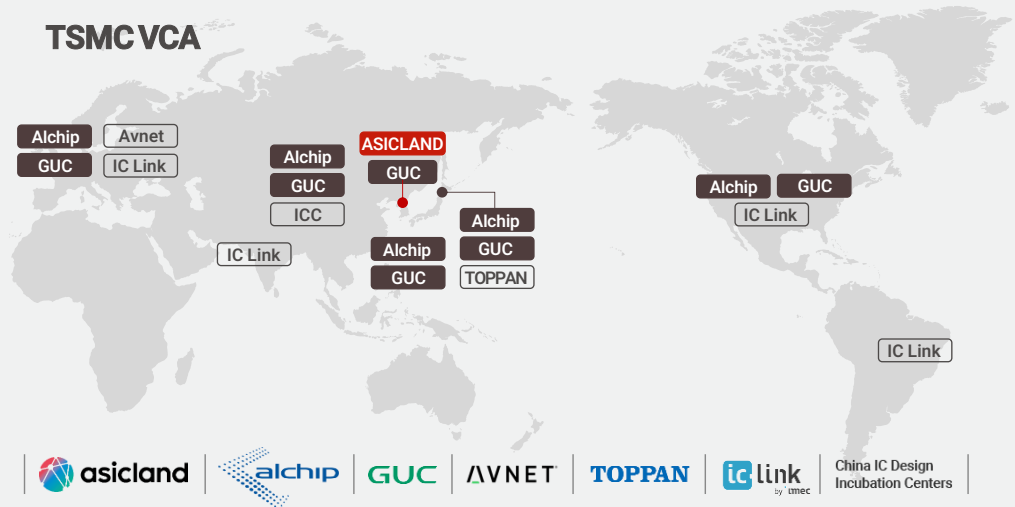
반도체 개발부터 생산까지 원스탑 토탈 솔루션 제공

IP Alliance 49,000개 이상의 IP 라이브러리 제공	DCA* 반도체 제조에 필요한 물리적 설계도 로디자인	EDA* Alliance TSMC의 공정 설계에 필요한 EDA Tool 제공
3DFabric Alliance 3D 패키징에 필요한 토탈 솔루션 제공	Cloud Alliance 반도체 설계에 필요한 클라우드 환경 제공	

* EDA: Electronic Design Automation | * DCA: Design Center Alliance | * VCA: Value Chain Alliance

TSMC VCA의 역할 (Value Chain Alliance)

TSMC VCA



VCA	국가	역할
ASICLAND	대한민국	*디자인 서비스
Alchip / GUC	대만	*디자인 서비스
Avnet	미국	공급망·유통 기반 VCA
IC Link (imec)	벨기에	설계 지원 플랫폼 (연구기관)
Toppan	일본	패키징·포토마스크
hina IC DesignIncubation	중국	정부·생태계 지원

Thankyou